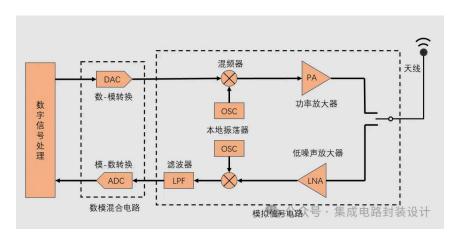
我们常说的PA、LNA 在射频系统中起什么作用?为什么封装时要控制线长?

原创 Old_Hao 集成电路封装设计 2025年09月16日 08:04

最近一个我比较尊重的深耕wire bond的老大哥突然问我: "射频芯片的PA是什么意思? 为什么一定要控制线长呢? "这个问题敷衍的回答就是射频芯片要进行阻抗匹配,线长会影响封装寄生参数,因此要精准控制其长度和形貌。这种敷衍的答案显然装X有余,诚意不足。我记得以前在做射频芯片封装的时候,IC设计工程师有给我讲过那么一嘴,当时感觉貌似理解了,今天就验证下这个牛X能吹成功不!各位轻喷! ↔

首先看下我在网上搜集到的典型射频系统框图。



数字信号处理部分:数字信号处理层,相当于整个系统的大脑。可以简单理解为信号的编码和解码。

数模混合电路部分:数-模、模-数转化与处理。这个我们可以简单理解为信号的"翻译"工作。将CPU给的数字信号变成适合远距离传输的模拟信号

(发射),或者把收到的模拟信号变回适合逻辑处理的数字信号(接收)。是连接数字世界和模拟无线电世界的桥梁。

模拟信号电路:将模拟信号通过本地震荡期调制到载波上,再将其放大以便远距离传输,或将接收到的微弱信号进行放大后并过滤取得有效部分给到ADC进行模数转换。我们传统封装最常见的两种射频芯片PA(功率放大器)和LNA(低噪声放大器)就处在这个模块下。

而最后的天线,便是无线信号发射、接收的桥梁。说到天线,让我联想到了当时《信号完整性分析》那本书里的一段话:

自由空间的特性阻抗有特殊的重要含义。前面提到,传输线上传播的信号实际是光波,信 导路径和返回路径约束并引导电磁波。电磁波传播场以光速在复合电介质中传播。

如果没有导线的引导,光就会以电磁波的形式在自由空间中传播。电磁波在空间传播时, 电场和磁场就会受到一个阻抗,这个阻抗与两个基本常数有关;自由空间的磁导率和自由空间 的介电常数,即

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi = 376.99 \approx 377 \Omega$$
 (7.15)

代人这两个常数,所得的结果就是电磁波受到的阻抗,称为**自由空间的特性阻抗**,其值约为377 Ω 。这个值很重要,当天线的阻抗与自由空间的特性阻抗(377 Ω)相匹配时,天线的辐

信号完整性与电源完整性分析(第三版)

140

射量是最优的。只有自由空间这个 377 Ω 的特性阻抗值具有根本性的意义。其他阻抗都可以是任意的。互连的特性阻抗可以是任意值,它只受到可制造性的限制。 集成 电路封装设计

大致是说当信号没有导线引导的时候,就会以电磁波的形式在自由空间传播。在自由空间中受到的阻抗是 377Ω ,当天线阻抗与自用空间阻抗匹配时,天线的辐射量达到最优。

说回我们传统封装中PA、LNA芯片封装时线长的影响。

首先线长会影响封装的寄生电感和电容(由于键合金丝都比较细,因此寄生电感起主导作用)。寄生电感和电容,对于阻抗匹配至关重要,可以参考下早期文章《案例分享:射频器件封装时,键合金丝间距为什么会对其性能产生影响》。

为什么要进行阻抗匹配呢?我们从字面意思理解下功率放大器和低噪声放大器,其本质就是将微弱的信号进行放大,使其便于远距离传输或者后级器件处理。记得以前设计工程师经常说的一个参数指标叫"增益",其在PA、LNA中的意义也和它的名字一样:描述器件对信号放大的能力。用一种不严格的理解方式,可以认为是输出功率比输入功率。

其计算方式: Gain(dB)=20×lg(|S21|)

可以看到,增益的大小与|S21|为正比关系。S21指的是输出信号与输入信号的比值,通常为电压或电流比。为什么用log函数表示?有一些资料上解释是log函数可以将很多复杂的数学运算简化为加减法,事情瞬间变得直观了许多。

因此S21的幅度直接表征了器件的增益。而这个增益值能否达到设计目标,严重依赖于端口的阻抗匹配。只有当输入输出端口都良好匹配时,增益才能接近理论最大值,器件的性能才最优。

这块本想就此一笔带过,写完发现这玩意还是有些复杂,自己看得也有点不清不楚。今 天先到这,后续抽时间问问专业的人,让他们给我讲讲S参数,写一篇封装工程师看得 懂的各种损耗相关专题!

下钟!

个人观点, 仅供参考